

【特徴】 導体幅が全体的に滲み状に太くなっている様相の太り。短絡と同居している場合も見られる

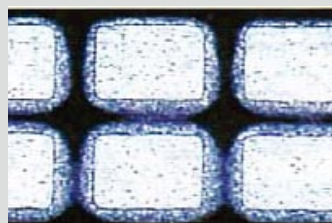
【特征】 有渗出的模様，整体的线宽变大，有时也与短路并存。

【Characteristics】 Conductor widths increase as the entire conductor edges look blurred. The increase coexists often with shorts

【原因・判断ポイント・発生工程】 DFR の露光後の熱被りにより出来たもの（露光焼付工程）

【原因、判断要点、发生工序】 DFR 曝光后的散热差而引起的（曝光工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 The increase is caused by thermal fogging of dry film image after exposure (Exposure process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

1-8 短絡／短路 / Electrical short

1-8-1 積層板銅箔面異物起因（短絡）／层压板铜箔面的杂物起因（短路） / Caused by foreign objects on the copper surface of laminate (Electrical short)

1-8-1-1 粘着性異物短絡／粘性杂物的短路 / Short by adhesive foreign material

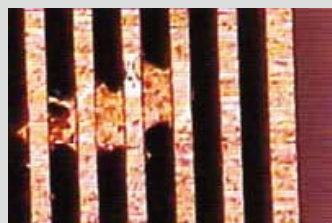
【特徴】 粘着性異物が E T レジストになった様相の短絡

【特征】 粘性杂物成为 ET 剂的短路。

【Characteristics】 Short caused by an adhesive foreign material acting as an etching resist

【原因・判断ポイント・発生工程】 積層板銅箔の表面に付着した粘着性異物が E T レジストとなった為に、めっき銅だけは E T されたが、積層板銅箔は E T されずに出来たもの（銅めっき前～ E T 工程）

【原因、判断要点、发生工序】 因为铜箔表面附着的粘性杂物成为 ET 剂，所以，只有镀铜层被 ET，而层压板铜箔不被 ET 所引起的（镀铜前～ ET 工序）。



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×